LAGENAUFBAU HDI (Standard)

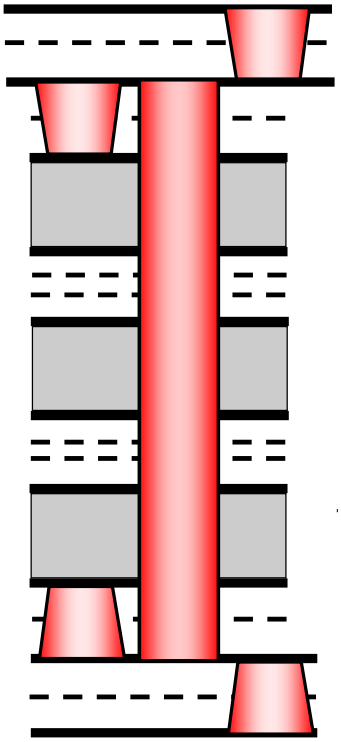
HDI10_2+6(8b)+2_1,00_17.5

10 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 6(8B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	12 µm		35	
					1 x 1080	66	
3	2			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
4	3			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
5	4			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
6	5			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
7	6			17.5 µm		16	
			0,100 mm			100	
8	7			17.5 µm		16	
					1 x 1080	66	
9	RSK1		Folie	12 µm		35	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm				
			Gesamtdicke Material:			1010	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,00**	+/-	0,08	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	18+